

卓上型プラズマクリーナー Tergeo-Pro



特長

高出力 RF パワー *

- ・標準 150W (オプション: 300 W or 500 W)

9 インチ大型チャンバーを装備

- ・内径: 230mm (9 インチ)、奥行: 340 mm
8" wafer, or 4" / 6" wafer boat に対応

ダイレクトプラズマソース CCP を装備

- ・CCP: Capacitively Coupled Plasma
- ・試料ダメージを低減出来るパルスモードを搭載可 (オプション)

7 インチ LCD タッチパネル制御

- ・20 レシピの保存, オート制御, 3 レシピのジョブシーケンスモード

マスフローコントローラを装備

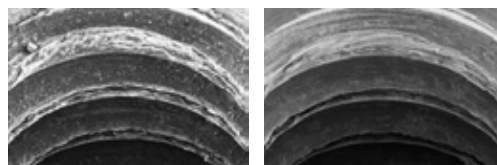
- ・2 系統 (オプションで 1 系統増設可) のマスフローコントローラ
でプロセスガスの流量制御

外部電極構造により微量金属汚染を低減

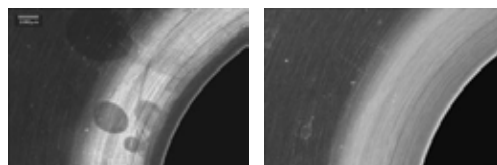
スロー Vent / Pump 機能搭載

アプリケーション

- コンタミネーション除去
- 親水化
- アッシング
- シリコンウェハ洗浄
- PDMS ボンディング
- ワイヤーボンディング面の改善
- 複合材料の結合改善 など



酸素プラズマ処理による金属部品のオイルコンタミネーションの除去
(左: 処理前、右: 処理後)



酸素プラズマクリーニングによるアルミニウム表面の有機物汚染の除去
(左: 処理前、右: 処理後)

お問い合わせはこちら!

ADS アド・サイエンス

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2ステージビルディング13F

☎ 03-6824-4510

🌐 <https://www.ads-img.co.jp/>



Tergeo シリーズ



	Tergeo-Pro	Tergeo-Plus	Tergeo-Basic
プラズマソース	ダイレクトモード： CCP (Capacitively Coupled Plasma) [容量結合型]	ダイレクトモード：CCP (Capacitively Coupled Plasma) [容量結合型] リモートモード：ICP (Inductively Coupled Plasma) [誘導結合型]	
クリーニングモード	オプション：ダメージを低減出来る『パルスモード』搭載可		
RF 出力* (@13.56MHz)	0 ~ 150 W (オプション：300 W or 500 W)		0 ~ 75 W (オプション：150 W)
チャンバーサイズ	内径：230 mm 奥行：340 mm 8" wafer, or 4" / 6" wafer boat	内径：160 mm 奥行：280 mm 6" wafer, or 4" wafer boat	内径：110 mm 奥行：280 mm 4" wafer boat
システム制御	7インチ LCD タッチパネル 20 レシピ保存, オート制御, 3 レシピのジョブシーケンスモード		
マスフローコントローラ	2 系統のマスフローコントローラで、プロセスガスの流量制御 (オプションで1 系統増設可) Vent / Pump は、別系統のソレノイドバルブで制御		
プラズマ強度センサー	プラズマ発光強度センサーを内蔵		
サイズ (W×H×D)	500×550×550 mm	500×300×430 mm	450×230×430 mm
重量	42 kg	28 kg	21 kg
電源	AC 90 ~ 250 V 50 / 60 Hz 単相 10 A (標準出力)		



Tergeo-EM

電子顕微鏡用途向け

- TEM 試料ホルダ 2 本装着可能
- 極低ダメージ (パルスモード) を標準装備
- 基本仕様は、Tergeo-Basic と同じ

* 本製品は 10kHz 以上の高周波電流を使用する高周波利用設備であり、その高周波エネルギーが 50W 以上に設定可能です。50W 以上の設定でご利用される場合は、電波法第 100 条に定められた通り、高周波利用設備設置のための必要書類を管轄の総務省地方総合通信局に提出する必要があります。